

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向招商银行申请贷款授信额度的议案》、《关于向上海银行申请贷款授信额度的议案》。为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司向银行申请授信额度情况如下：

1、向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

2、向上海银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三

次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018年8月11日